

11月12日(木)10:00-13:10、14:10-17:05	コース	11月12日(木)14:00-16:50	11月13日(金)10:30-13:00	11月13日(金)14:00-16:50
<p><b>KM-1 挨拶・基調講演</b> 10:00-13:10</p> <p>◆来賓挨拶 京都府知事 山田 啓二(予定) 京都市産業戦略監 白須 正</p> <p>◆基調講演 「宇宙航空研究開発機構(JAXA)の業務と宇宙用電子部品に求められる耐環境性」 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 安全・信頼性推進部 部品プログラム室 室長 根本 規生</p> <p>◆基調講演 「中国 BOEフラットパネル事業戦略」 BOEジャパン(株) 代表取締役社長 久島 力</p> <p>◆基調講演 「電子デバイスの微細化と市場環境変化における半導体製造装置ビジネスの役割」 (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役社長 須原 忠浩</p> <p>◆基調講演 「IoT/GPS社会におけるデータ・ストレージへのチャレンジ」 (株)東芝 常任顧問 齋藤 昇三</p>	<p><b>【A】次世代自動車</b></p> <p><b>【B】エネルギー革新を引き起こす電子材料</b></p> <p><b>【C】電子部品から見た最新IoT/M2M機器</b></p>	<p><b>A-1 ITSを支える自動運転技術</b> 山崎治(シャープ)/松浦正純(ルネサス)</p> <p>◆Robot of Everything ～人が運転するあらゆる機会にロボット 技術を～ (株)ZMP 代表取締役社長 谷口 恒</p> <p>◆車載用赤外線イメージング技術の最新動向 立命館大学 理工学部 教授 木股 雅章</p> <p>◆“ぶつからないクルマ？” スバルが生んだアイサイトの秘密 富士重工(株) スバル技術本部 車両研究実験第4部 部長 樋渡 稔</p> <p><b>B-1 究極のエネルギー：水素社会の幕開け</b> 中村孝(ローム)</p> <p>◆日本の水素エネルギー開発の現状 (株)ガスレビュー 取締役 編集長 小泉 善樹</p> <p>◆プロトン伝導性酸化物を用いた水素エネルギーデバイス 九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 教授 松本 広重</p> <p>◆固体酸化物燃料電池(SOFC)による家庭用コジェネの高発電効率化の現状と展望 大阪ガス(株) 商品技術開発部 シニアリサーチャー 鈴木 稔</p> <p><b>C-1 IoT/M2M機器の革新を支える電子部品</b> 山本浩之(マイクロン)</p> <p>◆IoTがもたらす未来、その時デバイスがつけつけられる要求とその解決のための取り組み (株)LSI生産本部 研究開発部 グループリーダー 内貴 崇</p> <p>◆豊かな未来のための安全・安心のサービスとビッグデータ・IoT セコム(株) 常務執行役員 IS研究所 所長 小松崎 常夫</p> <p>◆ロボットの将来像とそれを支える電子部品への期待 (株)安川電機 技術開発部 開発研究所 部長 野瀬 由喜男</p>	<p><b>A-2 次世代自動車におけるバッテリー/モータの進化</b> 松浦正純(ルネサス)</p> <p>◆ホンダの自動車開発への取り組み (株)本田技術研究所 四輪R&amp;Dセンター 第5技術開発室 室長 新村 光一</p> <p>◆EPSモータへの期待と機電一体技術 (株)デンソー 電気制御機器部 電気制御技術企画室 室長 伊藤 徳久</p> <p>◆次世代自動車用モータに向けた新たな取り組み ～ 磁気制御型可変特性モータ～ 日産自動車(株) 総合研究所 EVシステム研究所 主任研究員 加藤 崇</p> <p><b>B-2 究極の省エネを実現する電子材料・システム</b> 戸所義博(奈良先端大)/中村孝(ローム)</p> <p>◆エネルギーマネジメントとそれを支えるデバイス ニチコン(株) NEGST事業本部 執行役員 技師長 古矢 勝彦</p> <p>◆電力自由化に向けた、スマートグリッド/スマートメータ/スマートホーム への取り組みについて (株)エネテクトソリューション事業開発部 室長 高嶋 正也</p> <p>◆SiCデバイスの開発状況と太陽光発電用パワーコンディショナへの適用 三菱電機(株) 京都製作所 スマートエネルギー製造部 開発グループ 西尾 直樹</p> <p><b>C-2 センシング技術</b> 宮崎信(村田製作所)/小田川明弘(パナソニック)</p> <p>◆安心・快適・楽しい社会を実現するセンサとIoT (株)村田製作所 通信・センサ事業本部 センサ事業部 事業部長 児堂 義一</p> <p>◆工業・農業・医療など様々な検査機で利用可能な CIGS近赤外線イメージセンサ (株)LSI生産本部 研究開発部 CIGSイメージセンサ事業化プロジェクト プロジェクトリーダー 眞砂 紀之</p> <p>◆モバイルバイオセンシングの技術動向と当社が開発する遺伝子検査 <math>\mu</math>-TAS技術 パナソニック(株) オートモーティブ&amp;インダストリアルシステムズ 技術本部 基盤技術開発センター バイオセンシング開発部 主幹技師 田中 浩之</p>	<p><b>A-3 次世代自動車を導く次世代パワー半導体</b> 佐藤高史(京都大学)/中村孝(ローム)</p> <p>◆ワイドギャップ半導体パワーデバイスの研究開発状況と今後の課題 京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 准教授 須田 淳</p> <p>◆次世代パワー半導体モジュール技術 富士電機(株) 技術開発本部 電子デバイス研究所 次世代モジュール開発センター センター長 高橋 良和</p> <p>◆環境対応車両へのSiCパワーデバイス適用に向けた取り組み トヨタ自動車(株) ハワーエレクトロニクス開発部 主幹 戸田 敬二</p> <p><b>B-3 動き出す環境発電：光や熱が電気に</b> 戸所義博(奈良先端大)/山崎治(シャープ)</p> <p>◆エナジーハーベスティングのための有機系フレキシブル熱電変換材料/デバイス 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 特任教授 中村 雅一</p> <p>◆熊本県が推進する再生可能エネルギー戦略の全貌 熊本県商工観光労働部 新産業振興局長 渡辺 純一</p> <p>◆光電気化学セル(Photo-electrochemical cell)型人工光合成の取り組み (株)東芝 研究開発センター 有機材料ラボラトリー 研究主幹 御子柴 智</p> <p><b>C-3 先端材料・デバイス</b> 芳賀恒之(NTT)/雲梯隆夫(UNATE)</p> <p>◆ナノセルロースを用いたペーパーデバイスの開発 大阪大学 産業科学研究科 准教授 能木 雅也</p> <p>◆Light Field Cameraとその技術について (株)ニコン 映像事業部 開発統括部 基礎技術開発部 第一開発課 技監補 岩根 透</p> <p>◆物流用スマートパレットから始めるIoT ユービーアール(株) IT事業統括本部 主幹技師 田中 浩之</p>
<p><b>KM-2 マーケットセミナー</b> 14:10-17:05</p> <p>◆特別講演 「中国IT企業はどうして世界のトップ集団になったのか？」 ～ ハンナカ目線で見たら・・・～ エレコム(株) 顧問 高川 雄一郎</p> <p>◆特別講演 「世界の半導体産業は転換期を迎えている」 IHSグローバル(株) IHS Technology、Research Director 南川 明</p> <p>◆特別講演 「業績好調の電子部品メーカーの株式市場から見た評価及び今後の見通し」 (株)東海東京調査センター 企業調査部 シニアアナリスト 萩原 幸一郎</p> <p>◆特別講演 「電子デバイスの設備投資は国内回帰で活況！！」 ～電子部品は投資大型化、半導体/ディスプレイも健闘～ (株)産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉</p>	<p><b>【D】特別セッション①</b></p> <p><b>【E】特別セッション②</b></p>	<p><b>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォームと産学連携</b> 戸所義博(奈良先端大)</p> <p>第1部 講演 ◆表面分析技術の基礎と具体事例 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 准教授 服部 賢</p> <p>第2部 京都大学・大阪大学・奈良先端科学技術大学院大学のポスター展示・技術相談</p> <p><b>E-1 最新電子デバイス製造技術 ～レビュー～</b> 藤原健典(東レ)/不破保博(ローム)/岡田吉生(GF)/山本浩之(マイクロン)</p> <p>◆なぜ、シリコンウェーハ製造で日本が強いのか？ グローバルウェーハズ・ジャパン(株) 技術部 部長 泉妻 宏治</p> <p>◆日本の強みと残すべきもの！ リボンディスプレイジャパン(株) 代表取締役社長 須山 透</p> <p>◆やさしい電子部品講座 - なぜスマホには1000個以上の部品が使われるのか？ 電子部品の種類と動作 - (株)産業タイムズ社 特別顧問 加藤 一</p>	<p><b>D-2 今さら聞けない半導体基礎講座①</b> 廣田良浩(東京エレクトロン)/酒井滋樹(日新イオン機器)</p> <p>◆半導体のできるまで ～半導体デバイス・プロセスの基礎～ ウエストブレイン 代表 西久保 靖彦</p> <p>◆超小型水晶製品～どこよりも小さく、どこまでも小さく～への挑戦～ リバーエレクトリック(株) 商品開発部 次長 声沢 英紀</p> <p>◆表面波デバイスの現状と今後の技術展開 (株)村田製作所 通信・センサ事業本部 技術統括部 薄膜技術部 部長 戸井 孝則</p> <p>◆車載電子機器とEMC対策部品～なぜEMC対策部品が必要なのか TDK(株) テクニカルセンター マグネティクスビジネスグループ 技術サービスセンター 担当係長 石橋 武友</p>	<p><b>D-3 今さら聞けない半導体基礎講座②</b></p> <p>◆プラズマエッチングプロセス技術 東京エレクトロン(宮城) 宮城技術開発センター、グループリーダー 本田 昌伸</p> <p>◆イオン注入・拡散技術 ルネサスセミコンダクタマニファクチャリング(株) 技術統括部 主幹技師 黒井 隆</p> <p>◆半導体プロセス技術とデバイス特性 東北大学 未来科学技術共同研究センター 教授 寺本 章伸</p> <p><b>E-2 最新電子デバイス製造技術 ～一般電子部品～</b></p> <p>◆コグニティブデバイス実現へ向けた実装技術の新潮流 日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所 サイエンス&amp;テクノロジー部 折井 靖光</p> <p>◆半導体パッケージ用基板の最新動向 京セラサーキットソリューションズ(株) 有機材料部品第1事業部 井上 貴志</p> <p>◆FCBGA商品技術部 FCBGA商品技術課 責任者 井上 貴志</p> <p>◆高密度3次元実装を実現する実装技術と材料 千住金属工業(株) ハンダテクニカルセンター 研究員 立花 賢</p> <p>◆自動車市場へのFPCC用途展開 日本メクトロン(株) マーケティング室 主事 細谷 秀喜</p>